

2014-2020年中国半导体材料市场深度调研与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2014-2020年中国半导体材料市场深度调研与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/xincailiao1409/R91894LZJW.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-09-13

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2014-2020年中国半导体材料市场深度调研与投资前景研究报告》共十四章，报告对我国的市场环境、生产经营、产品市场、技术水平、产业链运行、企业竞争、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上，对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。

第一部分半导体材料行业发展概述

第一章半导体材料产业基本概述

第一节半导体材料的概述

一、半导体材料概念

二、半导体材料的分类

三、半导体材料的特点

四、化合物半导体材料介绍

第二节半导体材料特性和制备

一、半导体材料特性和参数

二、半导体材料制备

第二章2012-2013年半导体材料发展基本概述

第一节主要半导体材料概况

一、半导体材料的特性和参数

二、半导体材料的种类

三、半导体材料的制备

第二节其他半导体材料的概况

一、非晶半导体材料概况

二、GaN材料的特性与应用

三、可印式氧化物半导体材料技术发展

第三章2012-2013年世界半导体材料产业运行形势综述

第一节2012-2013年全球总体市场发展分析

- 一、全球半导体产业发生巨变
- 二、世界半导体产业进入整合期
- 三、全球半导体产业新进展
- 四、国际半导体市场增长减缓

第二节2012-2013年主要国家或地区半导体材料行业发展分析

- 一、比利时半导体材料行业分析
- 二、德国半导体材料行业分析
- 三、日本半导体材料行业分析
- 四、韩国半导体材料行业分析
- 五、中国台湾半导体材料行业分析

第四章 中国半导体材料行业发展环境分析

第一节 国内宏观经济环境分析

- 一、GDP历史变动轨迹分析
- 二、固定资产投资历史变动轨迹分析
- 三、2013年中国宏观经济发展预测分析

第二节 中国半导体材料行业政策环境分析

第五章2012-2013年中国半导体材料行业运行动态分析

第一节2012-2013年中国半导体材料行业发展概述

- 一、全球代工将形成两强的新格局
- 二、应加强与中国本地制造商合作
- 三、电子材料业对半导体材料行业的影响

第二节2012-2013年半导体材料行业企业动态

- 一、元器件企业增势强劲
- 二、应用材料企业进军封装
- 三、新政策对半导体材料业的作用

第三节2012-2013年中国半导体材料发展存在问题分析

第六章2012-2013年中国半导体材料行业技术分析

第一节2012-2013年半导体材料行业技术现状分析

- 一、硅太阳能技术占主导

二、有机半导体TFT的应用

第二节2012-2013年半导体材料行业技术动态分析

一、功率半导体技术动态

二、闪光驱动器技术动态

三、封装技术动态

四、太阳光电系统技术动态

第三节2014-2020年半导体材料行业技术前景分析

一、高能效驱动方案前景分析

二、计算机芯片技术前景分析

三、太阳能产业技术前景分析

第七章 2012-2013年中国半导体材料氮化镓产业运行分析

第一节2012-2013年中国第三代半导体材料相关介绍

一、第三代半导体材料的发展历程

二、第三代半导体材料得到推广

三、宽禁带半导体材料

第二节2012-2013年中国氮化镓的发展概况

一、氮化镓半导体材料市场的发展状况

二、氮化镓照亮半导体照明产业

三、GaN蓝光产业的重要影响

第三节 2012-2013年中国氮化镓的研发和应用状况

一、中科院研制成功氮化镓基激光器

二、方大集团率先实现氮化镓基半导体材料产业化

三、非极性氮化镓材料的研究有进展

四、氮化镓的应用范围

五、氮化镓晶体管的应用分析

第八章 2012-2013年中国其他半导体材料运行局势分析

第一节砷化镓

一、砷化镓单晶材料的发展

二、砷化镓的特性

三、砷化镓产业的发展应用状况

四、我国最大的砷化镓材料生产基地投产

第二节碳化硅

一、半导体材料碳化硅介绍

二、碳化硅材料的特性

三、高温碳化硅制造装置的组成

四、我国碳化硅的研发与产业化项目取得重大突破

第九章2010-2013年国内半导体材料行业（所属行业）数据监测分析

第一节 2010-2013年中国半导体材料行业（所属行业）总体数据分析

一、2011年中国半导体材料行业全部企业（所属行业）数据分析

二、2012年中国半导体材料行业全部企业（所属行业）数据分析

三、2013年中国半导体材料行业全部企业（所属行业）数据分析

第二节 2010-2012年中国半导体材料行业（所属行业）不同规模企业数据分析

一、2011年中国半导体材料行业（所属行业）不同规模企业数据分析

二、2012年中国半导体材料行业（所属行业）不同规模企业数据分析

三、2013年中国半导体材料行业（所属行业）不同规模企业数据分析

第三节 2010-2012年中国半导体材料行业（所属行业）不同所有制企业数据分析

一、2011年中国半导体材料行业（所属行业）不同所有制企业数据分析

二、2012年中国半导体材料行业（所属行业）不同所有制企业数据分析

三、2013年中国半导体材料行业（所属行业）不同所有制企业数据分析

第十章2012-2013年中国半导体市场运行态势分析

第一节LED产业发展

一、国外LED产业发展情况分析

二、国内LED产业发展情况分析

三、LED产业所面临的问题分析

四、2014-2020年LED产业发展趋势及前景分析

第二节集成电路

一、中国集成电路销售情况分析

二、集成电路产量统计分析

四、半导体集成电路产业发展趋势

第三节电子元器件

一、电子元器件的发展特点分析

二、电子元件产量分析

三、电子元器件的消费趋势分析

第四节半导体分立器件

一、半导体分立器件市场发展特点分析

二、半导体分立器件产量分析

三、半导体分立器件发展趋势分析

第五节其他半导体市场

一、半导体气体与化学品产业发展概况

二、IC光罩市场发展概况

三、中国电源管理芯片市场概况

第三部分半导体材料行业竞争分析

第十一章2012-2013年中国半导体材料行业市场竞争态势分析

第一节2012-2013年国外年半导体材料行业竞争分析

一、2012-2013年欧洲半导体行业竞争机构分析

二、2012-2013年欧洲半导体产业竞争分析

第二节2012-2013年我国半导体材料市场竞争分析

一、半导体照明应用市场竞争分析

二、单芯片市场竞争分析

三、太阳能光伏市场竞争分析

第三节2012-2013年我国半导体材料企业竞争分析

一、国内硅材料企业竞争分析

二、政企联动竞争分析

第十二章2012-2013年中国半导体材料主要生产商竞争性财务数据分析

第一节有研半导体材料股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第二节天津中环半导体股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第三节宁波康强电子股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第四节南京华东电子信息科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第五节峨眉半导体材料厂

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第六节洛阳中硅高科有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第七节北京国晶辉红外光学科技有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第八节北京中科镓英半导体有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第九节上海九晶电子材料有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第十节东莞钛升半导体材料有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第十一节河南新乡华丹电子有限责任公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第十三章2014-2020年中国半导体材料行业发展趋势分析

第一节2014-2020年中国半导体材料行业市场趋势

一、2014-2020年国产设备市场分析

二、市场低迷创新机遇分析

三、半导体材料产业整合

第二节2014-2020年中国半导体行业市场发展预测分析

一、全球光通信市场发展预测分析

二、化合物半导体衬底市场发展预测分析

第三节2014-2020年中国半导体市场销售额预测分析

第四节2014-2020年中国半导体产业预测分析

- 一、半导体电子设备产业发展预测分析
- 二、GPS芯片产量预测分析
- 三、高性能半导体模拟器件的发展预测

第十四章 博思数据关于半导体材料行业投资咨询分析

第一节2014-2020年中国半导体材料行业投资环境分析

第二节2014-2020年中国半导体材料行业投资机会分析

- 一、半导体材料投资潜力分析
- 二、半导体材料投资吸引力分析

第三节2014-2020年中国半导体材料行业投资风险分析

- 一、市场竞争风险分析
- 二、政策风险分析
- 三、技术风险分析

图表目录：

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）

图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）

图表：进出口总额（亿美元）

图表：广义货币（M2）增长速度（%）

图表：居民消费价格同比上涨情况

图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2012年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）

图表：2012年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2013年中国GDP增长预测

图表：国内外知名机构对2013年中国GDP增速预测

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，银行采集数据、税务部门采集数据、证券交易采集数据，商务部采集数据以及经济信息中心各类市场监测数据库

。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/xincailiao1409/R91894LZJW.html>